

# Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

## Produktbeschreibung

### Schnelle Details

|                        |   |                        |                                |
|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| Herkunftsort:          | Guangdong China (Festland)              | Markenname:            | O-Leading                      |
| Basismaterial:         | FR-4, Aluminium                         | Kupfer Dicke:          | 0,5 oz-5 oz                    |
| Mindest. Lochgröße:    | 0,2 mm                                  | Mindest. Linienbreite: | 0,2 mm                         |
| Oberflächenveredelung: | Immersiongold, OSP, bleifreies HASL     | Brettstärke            | 0,1-5 mm                       |
| anwendbar auf:         | LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen | Charakter:             | Industrielle Steuerungsplatine |
| Zertifikate:           | ISO9001, UL, RoHS, SGS                  | Q / CTN:               | 10PCS-100PCS                   |
| Gewicht:               | 0,01 kg bis 5 kg                        | MOQ:                   | 10 stück                       |
| Farbe                  | blau, rot, grün, schwarz                | Preis                  | \$ 0,1- \$ 10                  |
| Modell-Nr              | pcba-hersteller von energienbanken      | Größe                  | 0,01m3-10m3                    |
| Desigh-Typ             | Kundenanforderung                       | Mindest. Zeilenabstand | 0,2 mm                         |

### Verpackung & Lieferung

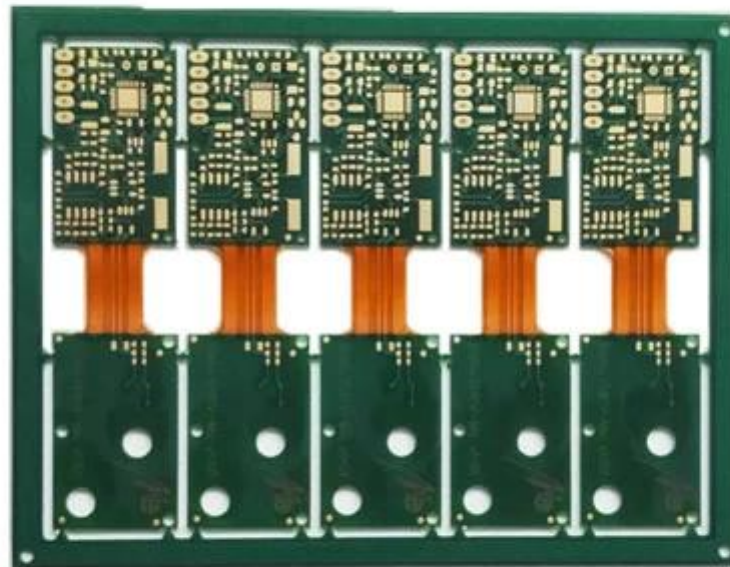
|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verpackungsinformationen: | 16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller |
| Lieferung Detail:         | 7-12days   |

### Produktbeschreibung

#### 16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenfertigung

| Artikel | 2014    |       | 2015 ~ 2016 |       | 2017 ~ 2018 |       |
|---------|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|         | Volumen | Probe | Volumen     | Probe | Volumen     | Probe |

|  |  |           |           |           |           |           |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schichtanzahl                          | 32   | 42        | 38        | 44        | 42        | 48        |
| Min Line / Abstand (µm)                | 50/50  | 40/45     | 40/45     | 40/40     | 35/40     | 35/35     |
| Min Bohrloch Durchmesser (mm)          | 0,15   | 0,10      | 0,15      | 0,10      | 0,15      | 0,10      |
| Seitenverhältnis von PTH               | 14: 1  | 16: 1     | 16: 1     | 18: 1     | 18: 1     | 20: 1     |
| N + C + N                              | 4 + C + 4  | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Beliebige Schichtverbindung            | 5 + 2 + 5  | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Plattenfüllung über                    | JA   | -         | JA        | -         | JA        | -         |
| Mindest. Kernstärke (ohne Kupfer) (µm) | 50   | 40        | 40        | 30        | 40        | 30        |
| Mindest. Laser Bohrer Durchmesser (µm) | 75   | 65        | 65        | 50        | 50        | 40        |
| Via auf begraben Loch / gestapelt via  | JA   | -         | JA        | -         | JA        | -         |
| Material                               | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.  |           |           |           |           |           |
| Embedded-Kondensator-PCB               | JA   | -         | JA        | -         | JA        | -         |
| Oberflächenprozess                     | Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Immersionssilber, Immersionsdose, Flash-Gold, Vergoldung mit Finger, Selektive Hartvergoldung, Abziehbare Lötmaske, Carbon-Tinte |           |           |           |           |           |



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

HDI-Leiterplatte Leiterplatte, Platine für schnelle Schaltung Leiterplatte

Unser Team





Zertifizierungen



**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**  
 Certificate No: 16118Q10347R05

**We hereby certify that**  
**O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED**  
 Credit No: 61691591-000-07-17-2  
 Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KL, HK  
 Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstui Town Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**  
 Which fulfills the requirements of the following standards  
 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

**Scope of certification**  
 Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018  
 This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021  
 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

|                             |                |                              |                |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| First supervision and audit | Qualified mark | Second supervision and audit | Qualified mark |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|

The certification registration scope doesn't include those products/services scopes which fail to be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be evaluated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the public website of company www.cicc.com.cn.

201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component

**UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY**

**ZPMV2.E490354**  
**Wiring, Printed - Component**

For enhanced search functionality, please visit [UL's e-Product Databases](#).  
 Click on a product designation for complete information.  
[Page Bottom](#)

**Wiring, Printed - Component**

[See General Information for Wiring, Printed - Components](#)

**O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED** E490354

Fortune Building, Nanheng West Road  
 Room 1313  
 Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

| Type   | Cond Width    |               |                    | SS/ DS/ Diam | Area       | Solder |      | Diper |     | Flame | RoHS | C |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|------------|--------|------|-------|-----|-------|------|---|
|  | Min           | Max           | Min                |              |            | Max    | Temp | Class |     |       |      |   |
| Hub/Bayer (mass laminate) printed wiring boards. |               |               |                    |              |            |        |      |       |     |       |      |   |
| <b>O-LEADING-401</b>                             | 0.2 (0.004)   | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)          | D6           | 12.7 (0.5) | 260    | 10   | 130   | V-0 | -     | -    | - |
| <b>O-LEADING-407</b>                             | 0.08 (0.003)  | 0.2 (0.008)   | 17 (0.67)          | D5           | 9.2 (0.4)  | 260    | 10   | 170   | V-0 | NI    | -    | - |
| Hub/Bayer printed wiring boards.                 |               |               |                    |              |            |        |      |       |     |       |      |   |
| <b>O-LEADING-408</b>                             | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) 31(1.25) | D6           | 50.8 (2.0) | 260    | 20   | 130   | V-0 | NI    | -    | - |
| Single layer printed wiring boards.              |               |               |                    |              |            |        |      |       |     |       |      |   |
| <b>O-LEADING-002</b>                             | 0.76 (0.015)  | 1.14 (0.045)  | 34 (1.34)          | S5           | 19.1 (0.8) | 260    | 10   | 105   | V-0 | NI    | -    | - |
| <b>O-LEADING-003</b>                             | 0.38 (0.015)  | 1.14 (0.045)  | 34 (1.34)          | S5           | 19.1 (0.8) | 260    | 10   | 130   | V-0 | ▲     | -    | - |
| <b>O-LEADING-033</b>                             | 0.15 (0.006)  | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)          | S5           | 25.4 (1.0) | 260    | 10   | 120   | V-0 | NI    | -    | - |
| <b>O-LEADING-205</b>                             | 0.1 (0.004)   | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)          | D6           | 69.6 (2.7) | 260    | 10   | 130   | V-0 | NI    | -    | - |
| <b>O-LEADING-206</b>                             | 0.15 (0.006)  | 0.33 (0.013)  | 17 (0.67)          | D5           | 69.6 (2.7) | 260    | 10   | 130   | V-0 | NI    | -    | - |

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.  
 Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

[http://www.ul.com/onlinecertifications/201VZL430354/Wiring,Printed-Component](#)



**Test Report** No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**  
 SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

**RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU**

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

| Test Item(s)               | Limit | Unit  | MDL | Det |
|----------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Cadmium (Cd)               | 100   | mg/kg | 2   | ND  |
| Lead (Pb)                  | 1,000 | mg/kg | 2   | 9   |
| Mercury (Hg)               | 1,000 | mg/kg | 2   | ND  |
| Hexavalent Chromium (CrVI) | 1,000 | mg/kg | 8   | ND  |
| Sum of PBBs                | 1,000 | mg/kg | -   | ND  |
| Monobromobiphenyl          | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Dibromobiphenyl            | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Tribromobiphenyl           | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Tetrabromobiphenyl         | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Pentabromobiphenyl         | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Hexabromobiphenyl          | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Heptabromobiphenyl         | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Octabromobiphenyl          | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Nonabromobiphenyl          | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Decabromobiphenyl          | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Sum of PBDEs               | 1,000 | mg/kg | -   | ND  |
| Monobromodiphenyl ether    | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Dibromodiphenyl ether      | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Tribromodiphenyl ether     | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Tetrabromodiphenyl ether   | -     | mg/kg | 5   | ND  |
| Pentabromodiphenyl ether   | -     | mg/kg | 5   | ND  |



SGS is pleased to announce the launch of its new online certification system for PCBs. This system is designed to provide a more efficient and transparent process for the issuance of certificates. The system is available at [www.sgscert.com](#). For more information, please contact your local SGS office or visit our website.

Member of the SGS Group (SGL SA)

## Verpackung & Lieferung

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Verpackungsinformationen | 16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller |
| Lieferungsdetails        | 7-12days   |



## FAQ

### 1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

### 2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium- / Kupferbasis, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenfinish → Routing → E / T → Sichtprüfung.